

Bohrungen \ Plattendicke	Plattendicke													
	25 µm	50 µm	75 µm	100 µm	125 µm	150 µm	200 µm	300 µm	500 µm	600 µm	700 µm	800 µm		
50 µm	> 90 % < 10 µm 45 min.	> 90 % < 10 µm 45 min.	> 90 % 10 µm 60 min.	> 90 % 10 µm 60 min.	> 90 % > 10 µm 90 min.								Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700	
75 µm	> 90 % 10 µm 60 min.	> 90 % 10 µm 60 min.	> 90 % > 10 µm 75 min.	> 90 % < 15 µm 45 min. < 30 min.	> 90 % 15 µm 60 min. < 30 min.	> 90 % > 15 µm 60 min. < 30 min.							Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700	
100 µm	> 90 % < 15 µm 30 min. < 30 min.	> 90 % 15 µm 45 min. < 30 min.	> 90 % > 15 µm 60 min. < 30 min.	> 90 % < 20 µm 75 min. < 30 min.	> 90 % 20 µm 60 min. 30 min.	> 90 % > 20 µm 75 min. < 30 min.	> 90 % > 25 µm 60 min. 45 min.						Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700	
125 µm		> 90 % > 15 µm 45 min. 30 min.	> 90 % < 20 µm 60 min. < 30 min.	> 90 % 20 µm 60 min. 30 min.	> 90 % > 20 µm 75 min. < 30 min.	> 90 % < 25 µm 75 µm 30 min.	> 90 % 25 µm 90 µm 30 µm	> 90 % 30 µm 90 min. 60 min.					Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700	
150 µm	> 90 % 20 µm 45 min. 45 min.	> 90 % 20 µm 60 min. 30 min.	> 90 % > 20 µm 75 min. < 30 min.	> 90 % < 25 µm 75 min. 30 min.	> 90 % 25 µm 75 min. 45 min.	> 90 % > 25 µm 90 min. 45 min.	> 90 % 35 µm 90 min. 60 min.	> 90 % 45 µm 90 min. 90 min.					Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700	
200 µm	> 90 % 25 µm 45 min. 60 min.	> 90 % 25 µm 60 min. 60 min.	> 90 % 25 µm 75 min. 45 min.	> 90 % 30 µm 75 min. 60 min.	> 90 % 30 µm 90 min. 60 min.	> 90 % 35 µm 105 min. 60 min.	> 90 % 45 µm 120 min. 60 min.	> 90 % 50 µm 120 min. 75 min.	> 90 % 55 µm 120 min. 90 min.				Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700	
250 µm						> 90 % 45 µm 120 min. 45 min.	> 90 % 50 µm 120 min. 60 min.	> 90 % 55 µm 120 min. 90 min.	> 90 % 65 µm 180 min. 90 min.	> 90 % 70 µm 210 min. 90 min.			Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700	
300 µm						> 90 % 55 µm 120 min. 75 min.	> 90 % 55 µm 120 min. 60 min.	> 90 % 60 µm 150 min. 60 min.	> 90 % 65 µm 180 min. 90 min.	> 90 % 70 µm 210 min. 90 min.	> 90 % 70 µm 240 min. 90 min.		Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700	
350 µm		<b>Die Angaben sind Richtwerte und müssen je nach Anforderung angepasst werden.</b>											> 90 % 80 µm 240 min. 120 min.	Füllgrad Kupferaufbau Badzeit THF Badzeit AVF 700